

		A室	B室	C室
9:15	登録受付 (1階エントランスホール)			
9:45	<p>[1A1] JIEP 低温フリーはんだプロジェクト (座長) 菅沼克昭(大阪大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 鉛フリープロジェクトの概要とアンケート調査結果須賀唯知(東京大学) 鉛フリーはんだCSP実装信頼性評価 竹内 誠(日本ビクター) 鉛フリーはんだの耐イオンマイグレーション性についての現状と今後の課題 津久井 勤(東海大学), 吉原佐知雄(宇都宮大学) 低温鉛フリーはんだの耐食性評価 田中浩和(タバイエスペック), 佐々木喜七(日本電子部品信頼性センター), 加藤能久(沖エンジニアリング), 津久井 勤(東海大学) 	<p>[1B1] 回路基板 めっき技術 (座長) 近藤和夫(岡山大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> エリソル[®]酸を還元剤とする無電解めっき浴の開発 倉科 匡, 平塚昌子(大和電機工業), 縄舟秀美(甲南大学) タッチパネル用透明電極を目的とした無電解ZnO皮膜の作製 西條義司, 田辺克久(上村工業), 伊崎昌伸(大阪市立工業研究所) Ni/Au-20Sn合金めっき皮膜界面の結晶組織 野沢由美, 倉科 匡(大和電機工業), 金子紀男, 篠原直行, 新井 進(信州大学) 改質されたポリイミド膜の吸着点の性質 田中伸明(信州大学), 吉谷昌明, 前原 隆(新光電気工業), 三島彰司, 藤井恒男(信州大学) 	<p>[1C1] 環境・リサイクル (座長) 吉原佐知雄(宇都宮大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 環境調和型品質機能展開を用いたICパッケージの環境調和型製品設計 小林 充, 田中博志, 竹ノ内敏一(新光電気工業) LCA手法を用いたICパッケージの環境ラベルタイプへの取組み 小林 充, 田中博志, 竹ノ内敏一(新光電気工業) 液晶モジュール輝点リペアへのレーザー応用 和田竹彦, 小林繁隆, 西田秀行(日本アイ・ピー・エム) 水素吸蔵合金薄膜を用いた接合部の分離技術 細田奈麻絵, 須賀唯知(東京大学) 	
10:57				
11:02	<p>[1A2] 鉛フリーはんだ Sn-Ag(Cu)系 (座長) 津久井 勤(東海大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 鉛フリーはんだQFP接合部の組織と信頼性 今村武史, 藤井俊夫, 廣瀬明夫, 小林紘二郎(大阪大学) 鉛フリーはんだとCuとの界面反応現象の検討 廣瀬明夫, 今村武史, 藤井俊夫, 小林紘二郎(大阪大学) 鉛フリーはんだ接合部に生じる疲労き裂の進展評価 高橋靖宏, 于 強, 白鳥正樹, 金 道燮(横浜国立大学) Sn/Ag多層めっきCuコアはんだボールとAu/NiめっきパッドとのBGA接合性評価 酒谷茂昭, 佐伯敏男, 小原泰浩, 上西啓介, 小林紘二郎(大阪大学), 山本雅春(住友特殊金属) 鉛フリーはんだ接合信頼性解析 酒井秀久(横浜国立大学), 西村一弘, 茂木正徳(富士通), 白鳥正樹, 于 強(横浜国立大学) 	<p>[1B2] 回路基板 銅めっき・エッチング (座長) 松岡政夫(立命館大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 添加剤の予備吸着を利用する銅電析プロセスによるULSI微細配線の形成 栗野まいこ, 赤松謙祐, 縄舟秀美, 水本省三(甲南大学), 内田 衛(石原薬品), 細田 勉(富士通) 穴埋めめっきにおける開口寸法の影響 岡村拓治, 田中善之助, 近藤和夫(岡山大学) スルーホールへの逆電解パルス銅めっきの適用 中村健次, 伴 和恵, 若林信一(新光電気工業), 金子紀男(信州大学) 電解銅箔の表面粗さ形成機構 島田久美子, 田中善之助, 近藤和夫(岡山大学) エッチング液による銅エッチング特性について 出口政史, 栗山雅代, 有村摩紀, 岡田万佐夫(メック) 	<p>[1C2] 評価・シミュレーション (座長) 貫井 孝(シャープ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 透過型電子顕微鏡および有限要素法によるACF接続における導電性粒子変形のマイクロ・キャラクターゼーション 辻 智, 辻本勝浩, 棚橋高成, 西田秀行(日本アイ・ピー・エム), 高橋真治(アイテス) QCM法を用いた層間マイグレーションに対する解析 植田文崇, 田中浩和, 糸川和博, 平松洋昭, 吉原佐知雄, 白樫高史(宇都宮大学) FLOTHERMを用いたT-BGAの熱抵抗シミュレーションモデル最適化 須田 亨, 細美英一, 池永守彦(東芝), 吉田 宏(東芝マイクロエレクトロニクス) 応答曲面法と遺伝的アルゴリズムを用いた熱設計用コンパクトモデリング技法 葛野正典, 西尾俊彦(日本アイ・ピー・エム), 小山田耕二(京都大学) 	
12:32	昼休み			
13:20	<p>[1A3] 鉛フリーはんだ Sn-Ag(Cu)系 (座長) 大塚正久(芝浦工業大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pbフリーはんだ接合強度とはんだ接合界面の解析 高瀬喜久(松下電子部品), 村尾正子(松下テクノリサーチ), 虎沢直樹, 坂 公恭(名古屋大学) BGA部品の鉛フリーはんだ接合信頼性検証 幸嶋 崇, 橋本知明, 笠谷泰司(三菱電機) Sn-Ag系およびSn-Cu系鉛フリーはんだの機械的特性評価 高橋浩之, 川上 崇, 向井 稔(東芝), 小林峰雄, 大野信忠(名古屋大学) Sn-Ag系鉛フリーはんだ合金の力学特性におよぼすペースメタル純度の影響 森畑智雄, 菊谷義治, 大塚正久(芝浦工業大学) 	<p>[1B3] 回路基板 加工技術 (座長) 江間富世(松下通信工業)</p> <ol style="list-style-type: none"> ガラスエポキシ基板のCO₂レーザ穴あけ加工技術 斑目 健, 高野 希, 馬場日男(日立化成工業) 未硬化スルーホール加工法を用いた高放熱コンポジット樹脂基板の開発 山下嘉久, 平野浩一, 中谷誠一(松下電器産業) 転写成形法による微細樹脂コアパンプ付きパッケージ基板 樋口和人, 唐沢 純, 菅 謙太郎, 君島 進(東芝), 子林みどり, 岸本泰一(東芝ケミカル) 多重重ね精度に対する分割投影露光機スケーリングの効果/多層PWBフォトリソグラフィプロセス 松木俊行, 田中米太(ウシオ電機) 	<p>[1C3] 精密加工・制御技術 (座長) 平田勝弘(三菱電機)</p> <ol style="list-style-type: none"> ウエハ薄化工程におけるプラズマストレスリリーフ技術の開発 有田 潔, 岩井哲博, 土師 宏(九州松下電器), 新田永留夢, 白 豊, 荒井一尚(ディスコ) 光熱磁気モータのマイクロ実装への応用 滝澤秀一, 牧村美加, 安澤真一(長野県工業試験場), 金子紀男(信州大学) 超微細打ち抜き金型による打ち抜き形状および金型拳動の解析 北島正邦, 若林信一(新光電気工業), 小杉 俊, 工藤誠一(長野県工業試験場), 山岸信夫(アピックヤマダ) 位置と力のハイブリッド制御による低荷重フリップチップボンダ 梅本和伸, 井上博文(日本電気) 	
14:32				
14:40	<p>[1A4] はんだ接合 (座長) 細田奈麻絵(東京大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> Sn-2.7Ag-0.9Cu合金を用いたソルダペースト 浜田好人(内橋エステック) はんだ組成が及ぼすパンプ変形能および接合強度への影響 伊達正芳, 佐藤光司(日立金属) 追いはんだと挿入部品の接合信頼性について 吉田 陽, 松原浩司, 中島隆志, 丸崎恒司(シャープ) はんだ中のCuがBGA接合部界面反応に及ぼす影響 上西啓介, 佐伯敏男, 小原泰浩, 小林紘二郎(大阪大学), 山本雅春(住友特殊金属) 	<p>[1B4] 回路基板 微細配線 (座長) 榎本 亮(イビデン)</p> <ol style="list-style-type: none"> フリップチップ実装における基板及び再配線チップに必要な配線幅 (特別講演) 傳田精一, 大竹 勉, 手塚佳夫, 三木一隆, 山崎隆夫(長野県工科短期大学校) 全層微細ピッチパッケージ 小山利徳, 小林和貴, 飯島隆廣, 若林信一(新光電気工業) 次世代実装技術に対応する微細配線パッケージ 小山昌一, 堀川奉愛, 飯島隆廣, 若林信一(新光電気工業) 超多ピンフリップチップパッケージ用新工法高密度有機多層基板 萩原清己, 林 桂, 藤崎昭哉, 堀 正明(京セラ) 	<p>[1C4] 設計支援システム (座長) 西田秀行(日本アイ・ピー・エム)</p> <ol style="list-style-type: none"> 半導体パッケージの熱、応力シミュレーションにおけるオブジェクト指向インターネットベースフレームワーク 松木隆一(新光電気工業), ラッセル・ピーク, ミヤコ・ウィルソン, ドナルド・クー, アンドリュ・スクラランド(ジョージア工科大学) プリント回路板設計工数・期間見積りシステム 山本純一, 辺見早智夫(沖コムテック) 共鳴する設計技術と製造技術(顧客満足を握るカギ) 坂本 敦, 白井治夫(シライ電子工業) 	
15:52				
16:05	<p>招待講演 (座長) 菅沼克昭(大阪大学)</p> <p>テラビットを目指す光電気複合実装技術の研究開発 茨木 修 氏 技術研究組合 超先端電子技術開発機構</p>	<p>EMオー A室：3階 MOホール B室：2階 第2会議室 C室：2階 第3会議室 受付：1階 エントランスホール</p>		
16:50	表彰式			
17:00	MES2000 ベストペーパー賞授与			
18:00	<p>*懇親会 会場/千里阪急ホテル(北大阪急行、大阪モノレール「千里中央駅」から徒歩5分) 18:00~20:00 料金/5,000円(消費税込み、MES参加費には含まれておりません)</p>			
20:00				